闽科资函〔2025〕55号

福建省科学技术厅关于推介科技型企业2025年第一批融资需求的函

各有关金融机构：

根据省委、省政府部署和省领导要求，我厅依托福建省金融服务云平台(以下简称“金服云”平台)建设科技创新主体融资需求库，面向全省科技型企业、科技创新平台等征集融资需求。目前我厅已完成第一批科技型企业融资需求征集，全省共有6971家高新技术企业及创新积分制70分以上企业在“金服云”平台填报了融资需求44.3493亿元。

请你们登录“金服云”平台网站https://www.fjjfypt.com/，选择“融资服务-待办事项-普通需求”或通过手机端登录“金服云”小程序，选择“我的需求-普通需求”查看第一批科技型企业融资需求具体信息，积极对接和服务企业科技融资需求。我厅将依托“金服云”平台定期统计、分析企业融资需求对接情况和效果，推动各有关部门、金融机构因企制宜、精准施策，更好服务企业科技创新需要。

福建省科学技术厅

2025年5月26日

（此件主动公开）

抄送：省委金融办、人民银行福建省分行、福建金融监管局。